

# 第三届高端制造电子电镀论坛（FEPAM-2024）在厦门召开



第三届高端制造电子电镀论坛（FEPAM-2024） 2024.05.11 厦门

图 | 大会合影

5月10日至12日，第三届高端制造电子电镀论坛（FEPAM-2024，简称“论坛”）在厦门召开。中国科学院院士、厦门大学党委书记张荣教授，中国科学院院士、厦门大学孙世刚教授，厦门市人民政府党组成员、副市长庄荣良，厦门市科技局副局长黄慰萍，中国化学

会电化学专业委员会主任、中国科学院长春应用化学研究所邢巍研究员，上海市电子学会电子电镀专委会名誉主任、复旦大学郁祖湛教授，国内各高校、科研院所师生以及高端制造电子电镀相关领域行业企业代表，近350人齐聚鹭岛，共话行业新发展。



图 | 张荣院士致辞

张荣院士致开幕辞。他表示，习近平总书记站在时代和战略的高度，创造性地提出新质生产力，为科技创新和产业发展指明了新方向。厦门大学作为高等教育的“国家队”，汇聚多学科优势，在今年全国两会召开后第一时间成立了新质生产力研究发展中心，着力为新质生产力加快发展提供重要引擎。高端电子制造是

推动新质生产力发展的重要领域，高端电子化学品更是半导体芯片制造业中不可缺少的关键性材料，能够有力助推相关产业提质升级。期待与会专家学者和产业专才碰撞出璀璨的思维火花，激荡出澎湃的创新动能，为我国高端制造电子电镀产业的高质量发展贡献新的智慧和力量。



图 | 庄荣良副市长致辞

庄荣良副市长提到，厦门市认真贯彻落实党中央国务院决策部署和省委省政府的工作要求，坚持一手抓科技创新，另一手抓产业创新，努力在中国式现代化征程中展现厦门经济特区的担当。2021年厦门市与厦门大学携手启动高端电子化学品国家工程研究中心的重组工作，合力推进解决集成电路产业领域的部分“卡脖

子”问题，促进科技创新和产业创新的融合发展。工程中心已经成功举办两届全国性高端制造电子电镀论坛，为学术界和产业界的交流与合作提供重要平台。期待与会专家加强与厦门市产业界携手开展更多科研创新、人才培养和产业合作，共同打造具有全球影响力的集成电路产业创新高地。



图 | 邢巍研究员致辞

邢巍研究员指出，高端电子电镀技术是实现纳米级电子逻辑互连和金属基微纳结构批量可控制造的关键技术，不仅关乎芯片的质量和性能，更是国家高端制造业竞争力的重要体现。要从源头攻关破解核心技术难题，迫切需要夯实电子电镀技术创新的理论根基。中国化学会

电化学专业委员会将一如既往支持电子电镀的创新发展，竭力组织人才队伍开展电子电镀核心基础科学问题的合力攻关，积极推动高校、科研院所与企业的产学研合作实践，加快目标导向的基础研究及电子电镀产业核心技术的重大突破。



图 | 行业对话

为推动高校院所与产业企业的深入交流，论坛特设行业对话专场，邀请高端制造电子电镀领域创新链、人才链、产业链及资金链代表，围绕“聚焦新态势·增强新动能·构建新引擎——高端制造电子

电镀新发展”主题，从高端电子化学品及电子电镀产业链上下游的各个环节，包括关键材料、核心设备、应用终端、投融资及前沿创新和人才支撑等方面，共话四链融合新模式，分享产业创新发展新思路。



图 | 孙世刚院士主持大会报告

本届论坛为期两天，设有“高端制造电子电镀基础、工艺技术与设备”、“芯片制造和封装集成电子电镀”、“高端电子化学品、下一代半导体（电子）材料”三个分会场，共安排4场大会报告、30场邀请报告、4场特约报告及14场口头报告。报告内容涵盖了前沿基础研究到产业应用实践的全链条创新，兼具高度、广度、深度，获得了与会嘉宾及代表的高度评价。张荣院士、邢巍研究员、上海交通大学李明教授、北京化工大学李群生教授分别作题为“显示用 Micro-LED 当前面临的瓶颈及技术进展”、“高端电子电镀重大基础科学问题研究的初步设想”、“大马士革钴互连超填充电镀机理与性能调控”、“高纯电子化学品制造新技术与应用”的大会报告。

论坛期间，主办方还组织参会嘉宾及代表参访厦门大学思明校区固体表面物理化学国家重点

实验室以及厦门大学翔安校区高端电子化学品国家工程研究中心（重组）。

高端制造电子电镀论坛（FEPAM）由中国科学院院士、厦门大学孙世刚教授于2022年倡议发起举办，是国内首个电子电镀领域贯通基础研究和产业应用的全国性行业论坛。论坛致力于探索高端制造电子电镀产业与科研的融通互联，创新行业产学研合作模式，为推进全链条核心技术提供权威、综合、开放的交流平台及空间。本届论坛由高端电子化学品国家工程研究中心（重组）主办，厦门大学化学化工学院、固体表面物理化学国家重点实验室、嘉庚创新实验室、国家集成电路产教融合创新平台、衢州高端电子化学品创新研究院协办。

（文 / 黄宝珍、曹京柱、黄瑞芸 图 / 庄华）